LAGENAUFBAU HDI (Standard)

HDI04_1+2+1_0,80_35

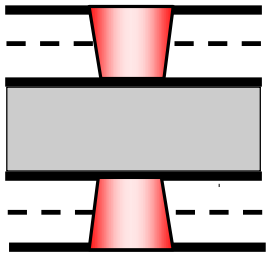
4 - Lagen

Kern: 0,61 mm Cu 35/35 µm

WE-Artikel Nr.: | **1 + 2 + 1**

KUNDE:

WÜRTH ELEKTRONIK

LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG
KUNDE	WE					[µm]	[µm]
1	TOP/VS		Folie	12 µm	1)	12	
					1 x 1080	60	
2	2			35 µm		33	
			0,610 mm			610	
3	3			35 µm		33	
					1 x 1080	60	
4	BOT/RS		Folie	12 µm	1)	12	

1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 50 µm

Gesamtdicke Material: 820

Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)

							Datum:	Bearbeiter:
MATERIALDICKE:	**0,80**	+/-	0,08	mm				
DICKE über galv. Endoberfläche	0,88	+/-	0,11	mm				
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	0,94	+/-	0,13	mm				
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:			

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision		
04.01.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	04.01.2006	R. Schönholz	00	Seite:	4+